

Microsoft 加入混合記憶體立方聯盟，該聯盟旨在打破記憶體壁壘

愛達荷州博伊西和加利福尼亞州聖約瑟，2012年5月7日（GLOBE NEWSWIRE）-- 由 Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MU）和 Samsung Electronics Co., Ltd. 共同領導的混合記憶體立方聯盟（HMCC）今日宣佈 Microsoft 已加入該聯盟。HMCC 是一個原始設備製造商、促成商和集成商合作組織，號召並彙集有志於聯合為名為混合記憶體立方（HMC）的創新記憶體技術開發和運用開放介面標準的聯盟。Micron 和 Samsung 是 HMCC 的初創成員，與 Altera, IBM、Open-Silicon、Xilinx 以及現在新加入的 Microsoft 緊密合作，以促進 HMC 技術在業內的廣泛應用。

該項技術將支援在從高性能計算到大規模網路等廣泛的行業產品上運用高效的記憶體解決方案。HMCC 開發團隊計畫向越來越多加入該聯盟的“應用者”提交一份介面規範草案。隨後，融合了開發者和應用者的團隊將推敲該草案並在今年底發佈該介面規範的定稿。

任何有興趣加入該聯盟並參與開發該規範的公司都可加入 HMCC 成為應用者成員。HMCC 現已收到超過 75 家有意向的潛在應用者成員的詢問。

預計 HMC 在性能、封裝和功耗上的能力將大大超越當前和近期的記憶體架構，對當前的記憶體技術提供重大轉變。聯盟為開發者、製造商和架構師打開了一扇新的大門，現在正致力於使 HMC 成為高性能記憶體技術的新一代標準。

“HMC 技術代表了通往增加記憶體頻寬和性能的同時減少能耗和在記憶體陣列與處理器內核之間資料傳輸延遲的方向上跨進一大步，” Microsoft 戰略軟體/矽架構總經理 KD Hallman 說到。“將這個解決方案運用到未來的系統上將導致更好的和/或新的數位體驗。”

業內面臨的主要挑戰之一和成立 HMCC 的關鍵動機 -- 是在於高性能計算和下一代網路設備所需的記憶體頻寬已大大超過傳統記憶體架構能提供的極限。術語“記憶體壁壘”就是用於形容這一困境。打破記憶體壁壘需要像 HMC 這樣能夠提供更大密度和更寬頻寬並顯著減少能耗的架構。

在 www.hybridmemorycube.org 可以找到應用該技術的額外資訊、技術規範、工具和支援。

關於 HMCC

由在全球半導體界處於領先地位的成員創立，混合記憶體立方聯盟（HMCC）致力於開發和建立混合記憶體立方技術的行業標準介面規範。該聯盟現有成員包括 Micron, Samsung、Altera、Open-Silicon、Xilinx、IBM 和 Microsoft。另有超過

75 名預期將成為聯盟應用者的成員。欲瞭解更多有關 HMCC 的資訊，請訪問 www.hybridmemorycube.org。

聯繫方式： Scott Stevens

Micron Technology, Inc.

+1.512.288.4050

sstevens@micron.com

John Lucas

Samsung Electronics Co., Ltd.

408-544-4363

j.lucas@ssi.samsung.com